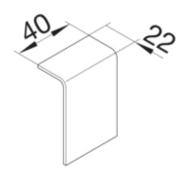


Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x55mm sucupira

## SL200557D6



## Architecture

| Mode de fixation              | serrage               |
|-------------------------------|-----------------------|
| Fonctions                     |                       |
| Chevauchement                 | oui                   |
| Porte, couvercle              |                       |
| Couvercle avec joint          | -                     |
| Matières                      |                       |
| Couleur                       | Sucupira              |
| Matière                       | PC-ABS                |
| Groupe de matériau            | plastique             |
| Type de traitement de surface | tampographié          |
| Dimensions                    |                       |
| Hauteur de goulotte           | 55 mm                 |
| Largeur de goulotte           | 20 mm                 |
| Equipement                    |                       |
| Avec film de protection       | non                   |
| Standards                     |                       |
| Homologations                 | CE                    |
| Directive européenne RoHs     | conformité volontaire |
| Sécurité                      |                       |
| Indice de protection IP       | IP40                  |
| Sans halogène                 | oui                   |
| oans nalogene                 | Oui                   |

## Conditions d'utilisation

| Température de service | 5 60 °C |  |
|------------------------|---------|--|
| Température            |         |  |
| Température ambiante   | 5 60 °C |  |